

TM 150 系列可焊接导电胶 产品数据表

增强可靠性

提升导热性能

消除放气现象

简介

TM 150 系列可焊接导电胶是一类快速固化、自填充、自流平、自焊接的功能性胶黏材料，可作为 LED、CSP、QFP 等器件的芯片粘接材料，用于替代传统银基导电胶或焊接材料(如焊膏或焊片)。与传统银基导电胶相比，TM 150 系列具有更稳定且更优异的电导率与热导率，能够轻松填充芯片与基板之间的间隙，实现芯片自流平，并且易于精确控制粘接层厚度(BLT)。与传统焊接材料相比，TM 150 系列可焊接导电胶可消除焊接过程中的析气问题，避免芯片偏斜、位移以及焊料渗流等缺陷。在固化过程中，焊接界面会被 TM 150 系列材料形成的三维聚合物网络结构所包覆，从而有效保护焊接金属界面，使其在严苛环境条件下仍能保持优异的可靠性与长期稳定性

物理特性

产品名称	TM 150系列可焊黏合劑
合金	銀
樹脂	環氧樹脂
未固化材料性能	
项目	数值
比重(ASTM D 1475-60)	3.5 – 4.5 g/cc
粘度	20 – 50 kcp
已固化材料性能	
拉伸强度(MPa)	56
C.T.E (ASTM E831) PPM/°C	23.5
杨氏模量(GPa)	26.3

導熱係數 (W/mk)	60-90
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面绝缘电阻 (J-STD-004)	通过 (Pass)

推荐固化条件

180 °C × 30 分钟

注:30 分钟的固化时间不包含粘接界面升温至目标固化温度所需的时间。

可根据具体应用需求评估并采用其他替代固化工艺条件。

储存与保质期

在 -40 °C 条件下, 材料若存放于密封的原始包装容器中, 保质期为 6 个月。超过该期限储存, 可能导致材料粘度升高。请避免受潮、挥发及外来杂质污染。蒸发或污染可能对材料的加工性能产生不利影响。

安全須知

TM150 为环保、无毒材料。但在使用和操作过程中, 仍建议遵循一般工业卫生操作规范。如需了解更详细的安全信息, 请参阅本产品的 SDS (安全数据表)

包装规格

TM 150 焊錫膠有 10cc 規格 10 cc 及 30 cc 注射器包装。亦可根据客户需求提供其他包装形式, 订购详情请联系 YINCAE。